



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

先进封装有望拉动封测板块回暖，算力基础设施迎来布局新时点

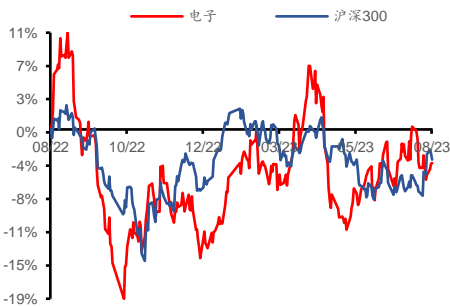
——电子行业周报（2023.07.24-2023.07.28）

增持（维持）

行业： 电子
日期： 2023年08月02日

分析师： 王珠琳
Tel: 021-53686405
E-mail: wangzhulin@shzq.com
SAC 编号: S0870523050001
联系人： 马永正
Tel: 021-53686147
E-mail: mayongzheng@shzq.com
SAC 编号: S0870121100023

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《AI 需求有望带动晶圆代工/组装成长，拉货旺季或促 IC 设计业绩回暖》

——2023 年 07 月 24 日

《23Q2 OLED 手机面板需求恢复，建议关注 DDIC 产业链投资机会》

——2023 年 07 月 24 日

《电视面板价格有望继续上行，建议关注华为 AI 存储新品发布事件催化》

——2023 年 07 月 18 日

■ 核心观点

市场行情回顾

过去一周（07.24-07.28），SW 电子指数下跌 0.88%，板块整体跑输沪深 300 指数 5.35 pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品 II、消费电子、元件、其他电子 II、半导体涨跌幅分别为-0.73%、-0.91%、-1.01%、-0.47%、-1.56%、-0.99%。

核心观点

先进封装：全球封测行业依旧承压，先进封装需求激增，产业链相关公司迎来布局时点。据 IDC，2022 年全球封测市场规模达 445 亿美元。但受到库存调整，上半年诸多封测厂的产能利用率为 50%-65%，预估 2023 年全球封测市场规模将同比减少 13.3%。然而先进封装产能却供不应求，目前台积电计划斥资 900 亿元新台币设立生产先进封装的晶圆厂以满足日益饱满的订单，三星电子也在加快布局。我们认为，受益于 AI 芯片和 HBM 需求带动，先进封装将成为拉动封测产业稼动率回升的契机，各大厂商将加速先进封测产能布局。

算力：智能算力引领数据新时代，中国智能算力设施增量空间广阔。华为预测，到 2030 年人类将进入 YB 数据时代，通用算力将增长 10 倍，人工智能算力将增长 500 倍。工信部发言人赵志国称，目前我国算力总规模居全球第二，保持 30%左右的年增长率，新增算力设施中智能算力占比过半，且根据华为预测，我国每年通用服务器采购量约 400 万-500 万台。我们认为，AI 产业链推动的算力需求将拉动以数据中心、服务器为中心的算力基础设施建设，围绕其服务、提升运行效率的功率分立器件、被动元件等板块都将受到带动。

专属云：中国专属云市场增速显著，市场集中度&客群服务范围双提升。根据 IDC 最新报告显示，2022 年下半年，专属云服务市场同比增长 27.1%，整体市场规模达 165.2 亿元人民币。其中专属托管云服务/专属云即服务市场同比分别增长 26.0%/152.3%。我们认为，AI 产业链的火热将持续强化算力需求，随着国内运营商及头部厂商加快投资布局，专属云市场集中度进一步提升的同时也将拓宽专属云服务客群范围。IDC 还预计到 2027 年专属云市场规模将突破 1,000 亿元人民币。

自动驾驶芯片：自动驾驶半导体市场高速增长，芯片、汽车行业公司争夺主导地位。受益于自动驾驶技术从汽车扩展到船舶、飞机和机器人，麦肯锡公司发布报告显示，全球自动驾驶半导体市场预计将从 2019 年的 110 亿美元增长到 2030 年的 290 亿美元。三星电子、英伟达、高通、台积电及特斯拉、现代汽车正在激烈竞争市场主导地位。

■ 投资建议

维持电子行业“增持”评级，我们认为 2023 年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率依然处于 2018 年以来历史较低位置，同时风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计类标的和部分超跌标的里面行业轮动机会，AIOT SoC 芯片建议关注中科蓝讯、乐鑫科技和炬芯科技；XR 产业链建议关注兆威机电与华兴源创；建议重点关注驱动芯片领域的峰昭科技、必易微、中微半导体、明微电子、汇成股份；半导体设备材料建议重点关注深科达、金海通、新益昌和台海诚科；建议关注国内头部功率供应商：时代电气，士兰微，新洁能，宏微科技，东微半导体，扬杰科技等，建议关注可立克，京泉华，江海股份等核心元器件供应商，同时建议关注 LED 产业链的兆驰股份、卡莱特和奥拓电子等个股。

■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。

目 录

1 市场回顾	3
1.1 板块表现	3
1.2 个股表现	4
2 行业新闻	5
3 公司动态	6
4 公司公告	9
5 高频数据追踪	10
6 风险提示	13

图

图 1: SW 一级行业周涨跌幅情况 (07.24-07.28)	3
图 2: SW 电子二级行业周涨跌幅情况 (07.24-07.28)	3
图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (07.24-07.28)	4
图 4: 全球半导体销售额 (单位: 百万美元, 截至 2023 年 5 月)	10
图 5: 全球智能手机季度出货量 (单位: 千部, 截至 2023 年 3 月)	10
图 6: 中国智能手机月度出货量 (单位: 万部, 截至 2023 年 5 月)	10
图 7: 电视面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)	11
图 8: 显示器面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)	11
图 9: 笔记本面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)	11
图 10: 手机面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 8 月预测)	12
图 11: DRAM 价格 (单位: 美元, 截至 2023 年 7 月 28 日)	12
图 12: NAND Flash 价格 (单位: 美元, 截至 2023 年 5 月)	12

表

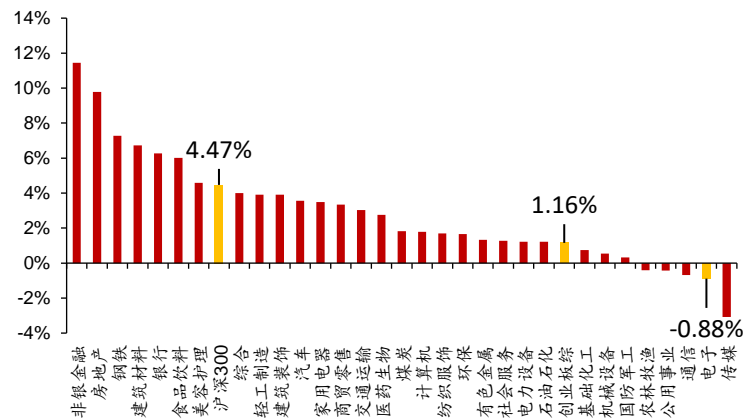
表 1: 电子板块 (SW) 个股过去一周涨跌幅前 10 名 (07.24-07.28)	4
表 2: A 股公司要闻核心要点 (07.24-07.28)	9

1 市场回顾

1.1 板块表现

过去一周（07.24-07.28），SW 电子指数下跌 0.88%，板块整体跑输沪深 300 指数 5.35 pct、跑输创业板综指数 2.04 pct。在 31 个子行业中，电子排名第 30 位。

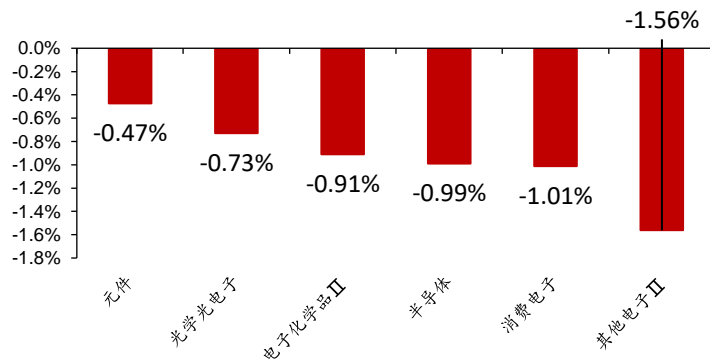
图 1：SW 一级行业周涨跌幅情况（07.24-07.28）



资料来源：iFinD，上海证券研究所

过去一周（07.24-07.28）SW 电子二级行业中，元件板块下跌 0.47%，跌幅最小；跌幅最大的是其他电子 II 板块，下跌 1.56%。光学光电子、电子化学品 II、消费电子、元件、其他电子 II、半导体涨跌幅分别为 -0.73%、-0.91%、-1.01%、-0.47%、-1.56%、-0.99%。

图 2：SW 电子二级行业周涨跌幅情况（07.24-07.28）

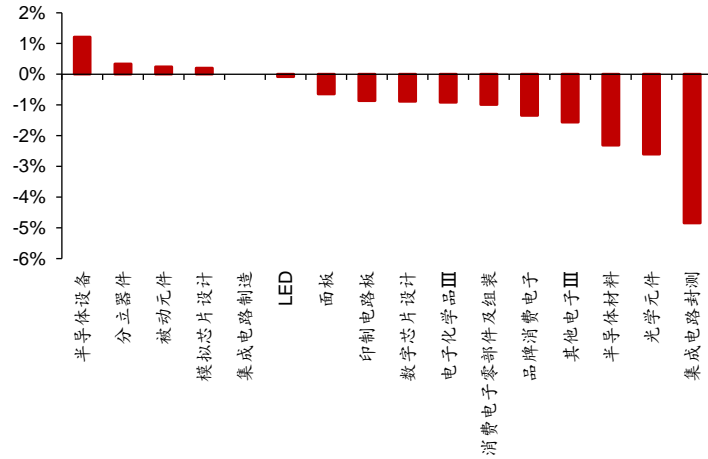


资料来源：iFinD，上海证券研究所

上周（07.24-07.28）SW 电子三级行业中，半导体设备板块

上涨1.21%，涨幅最大；涨跌幅排名后三的板块分别为集成电路封装、光学元件以及半导体材料板块，涨跌幅分别为-4.84%、-2.61%、-2.31%。

图 3: SW 电子三级行业周涨跌幅情况 (07.24-07.28)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

1.2 个股表现

过去一周 (07.24-07.28) 涨幅前十的公司分别是百邦科技 (11.63%)、骏成科技 (9.50%)、维峰电子 (8.14%)、宏昌电子 (6.94%)、联创光电 (6.94%)、顺络电子 (6.61%)、乐凯新材 (5.40%)、电连技术 (5.30%)、ST 星星 (4.82%)、艾华集团 (4.81%)，跌幅前十的公司分别是甬矽电子 (-24.31%)、杰美特 (-19.38%)、德邦科技 (-18.96%)、和林微纳 (-17.96%)、天山电子 (-16.00%)、中富电路 (-15.98%)、联动科技 (-15.81%)、源杰科技 (-15.20%)、耐科装备 (-13.85%)、富信科技 (-13.68%)。

表 1: 电子板块 (SW) 个股过去一周涨跌幅前 10 名 (07.24-07.28)

周涨幅前 10 名			周跌幅前 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周涨幅(%)
300736.SZ	百邦科技	11.63%	688362.SH	甬矽电子	-24.31%
301106.SZ	骏成科技	9.50%	300868.SZ	杰美特	-19.38%
301328.SZ	维峰电子	8.14%	688035.SH	德邦科技	-18.96%
603002.SH	宏昌电子	6.94%	688661.SH	和林微纳	-17.96%
600363.SH	联创光电	6.94%	301379.SZ	天山电子	-16.00%
002138.SZ	顺络电子	6.61%	300814.SZ	中富电路	-15.98%
300446.SZ	乐凯新材	5.40%	301369.SZ	联动科技	-15.81%
300679.SZ	电连技术	5.30%	688498.SH	源杰科技	-15.20%
300256.SZ	ST 星星	4.82%	688419.SH	耐科装备	-13.85%
603989.SH	艾华集团	4.81%	688662.SH	富信科技	-13.68%

资料来源: iFinD, 上海证券研究所

2 行业新闻

IDC: 2022 下半年中国专属云服务市场同比增长 27.1%

7月24日，国际数据公司（IDC）最新发布的《中国专属云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022下半年，专属云服务市场同比增长27.1%，整体市场规模达165.2亿元人民币。其中专属托管云服务市场同比增长26.0%，规模达162.4亿元人民币；专属云即服务市场同比增长152.3%，规模达2.82亿元人民币，即服务市场依然处于发展初期，对整体市场贡献有限，仅占据1.7%的份额。（资料来源：IDC）

SEMI: 第二季度全球硅晶圆出货量环比增长 2.0%，同比下滑 10.1%

7月26日，《科创板日报》26日讯，SEMI最新报告显示，2023年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长2.0%，达到33.31亿平方英寸，较去年同期的37.04亿平方英寸下降10.1%。半导体行业继续应对各个细分市场的库存过剩问题，因此，2023年二季度硅晶圆出货量落后于2022年同期的峰值，出货量环比保持稳定，其中300mm晶圆在所有晶圆尺寸中均呈现季度增长。（资料来源：科创板日报）

2023 年上半年芯片进口显示国产化成效显著

7月27日，据全球半导体观察报道，在国产化浪潮趋势的推动下，中国集成电路产品生产数量逐渐增加。据工信部此前发布的数据显示，今年前5个月，我国集成电路产量达1401亿块，同比增长0.1%。近日中国海关总署披露的2023年6月全国进出口重点商品量值表（美元）亦显示，中国集成电路产品正在逐渐摆脱国外依赖。数据显示，今年上半年，中国芯片进口数量和进口总值较去年同期都有明显减少，其中，进口数量较去年减少了518.1亿个，进口总值相比去年减少了470.64亿美元。（资料来源：全球半导体观察）

2023 年第二季度全球智能手机出货量跌势放缓

7月27日，Canalys发布数据，2023年第二季度，全球智能手机市场同比下降10%，达2.58亿部，市场衰退有所放缓。三星以5300万部的出货量稳居榜首。苹果以17%的市场份额和4300万部出货量保持第二。随着库存水平逐渐正常化，小米以3320万部的出货量，排名第三。OPPO（包括一加）以10%的市场份额稳

居第四。传音（包括 Tecno、Infinix 和 iTel 品牌）受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张，首次跃升至前五，出货量为 2270 万部，年增长率达 22%。（资料来源：Canalys）

存储器厂商：整体产业已筑底，2023 年四季度有望回稳

7 月 28 日，据全球半导体观察报道，受终端市场带来的下行风气影响，存储器市场仍处于供过于求，亟待解决高库存去化等问题。针对产业未来发展，近期，南亚科、威刚等存储器厂商表示看好整体产业已筑底，四季度供需有望恢复平稳。南亚科总经理李培瑛指出，二季度 DRAM 供应商积极去化库存，加上各厂都在调控产能与资本支出，因此三季度 DRAM 产品价格虽然有涨有跌，不过整体价格跌幅收敛、销售量微幅增加，产业已在二季度筑底，下半年有机会逐步改善，预期四季度供需可望恢复平稳。威刚董事长陈立白分析，上游供货商对 DRAM 价格态度转趋正向，议价空间紧缩，伴随减产效益在三季度显现，加上终端客户的 DRAM 库存水位普遍回复健康，预计本季 DRAM 合约价跌幅将明显收敛，现货价则可望领先起涨。（资料来源：全球半导体观察）

3 公司动态

【AMD】AI 半导体将年均增长 50%

7 月 24 日，科创板日报援引日本经济新闻，AMD 首席执行官苏姿丰（Lisa Su）日前接受采访称，用于人工智能（AI）的半导体市场将在今后 3-4 年里年均增长 50%。AMD 将推出用于 AI 处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的美国英伟达。（科创板日报）

【晶盛机电】公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底工艺和技术

7 月 25 日，晶盛机电在互动平台表示，公司已掌握行业领先的 8 英寸碳化硅衬底工艺和技术，公司通过自有籽晶经过多轮扩径，成功生长出 8 英寸 N 型碳化硅晶体，解决了 8 英寸碳化硅晶体生长过程中温场不均，晶体开裂、气相原料分布等难点问题。公司建设了 6-8 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，通过持续加强技术创新和工艺积累，加快碳化硅衬底材料的发展进程。（资料来源：财联社）

【沃格光电】公司玻璃基半导体封装载板部分产品已通过客户验证通过

7月25日，沃格光电在投资者互动平台表示，公司TGV产品主要应用于Mini/Micro直显和半导体封装基板，Mini/Micro直显产品方面玻璃基能实现更低的pitch值，目前有多款产品与国内知名企业处于合作开发验证阶段；半导体封装基板方面，玻璃基的高平整度、低热膨胀系数、更低的介电损耗、更优的耐热性以及散热性能、更高的线路精密度，对于半导体封装尤其是先进封装领域所要求的降功耗、更高的信号传送速度和功率效率、更强的芯片稳定性尤为重要，可应用于存储、算力、光模块封装基板等产品。（资料来源：界面新闻）

【台积电】计划斥资900亿元新台币设立生产先进封装的晶圆厂

7月25日，据中国台媒工商时报消息，因先进封装产能供不应求，台积电计划斥资900亿元新台币（约合人民币205.84亿元）设立生产先进封装的晶圆厂，预计创造约1500个就业机会。台积电表示，将打造最新CoWoS先进封装厂，预估2023年第四季开始整地，2024年下半年开始动工，2026年建厂完成，力拼2027年上半年、最迟第三季开始量产，并以月产能11万片12英寸晶圆的3DFabric制程技术产能，纾缓爆发的需求。（资料来源：全球半导体观察）

【美光】推出Crucial X9/X10Pro便携式SSD

7月26日，美光宣布推出Crucial X9 Pro便携式SSD和Crucial X10 Pro便携式SSD，均采用美光TLC NAND并利用革命性的单ASIC便携式存储架构。两款产品现已开售，容量为4TB、2TB和1TB。其中，Crucial X9 Pro的顺序读写速度可达1050MB/s，通过USB-C连接即插即用，可与Windows、Mac、Android设备等配合使用。其尺寸仅为65x50毫米，重量仅38克。Crucial X10 Pro是美光迄今为止提供的速度最快的外接式SSD，顺序读/写速度分别高达2100MB/s和2000MB/s。（资料来源：全球半导体观察）

【意法半导体】汽车需求推动销量，二季度收入同比增13%

7月27日，由于汽车行业的需求推动了销售，意法半导体2023年第二季度收入同比增长13%，超出预期。该公司周四在第二季度业绩声明中表示，第二季度收入增至43.3亿美元。意法半导体首席执行官Jean-Marc Chery在声明中表示：“收入表现继续受到汽车和工业领域增长的推动，但部分被个人电子产品收入下降所抵消。”（资料来源：科创板日报）

【泛林集团】AI 需求推动，公司提高一季度收入预期

7 月 27 日，半导体设备供应商 Lam Research（泛林集团）预测 2023 年第一季度收入高于华尔街预期，因为半导体制造商正积极满足人工智能推动的半导体需求激增。该公司 CEO Tim Archer 表示，人工智能正处于初级阶段，对工厂和制造设备的更多投资在未来几年至关重要，“与传统服务器相比，先进的人工智能服务器具有明显更高的前沿逻辑、内存和存储内容，人工智能服务器和数据中心的渗透率每增加 1%，预计将带动 10 亿至 15 亿美元的额外（芯片设备）投资。”（资料来源：科创板日报）

4 公司公告

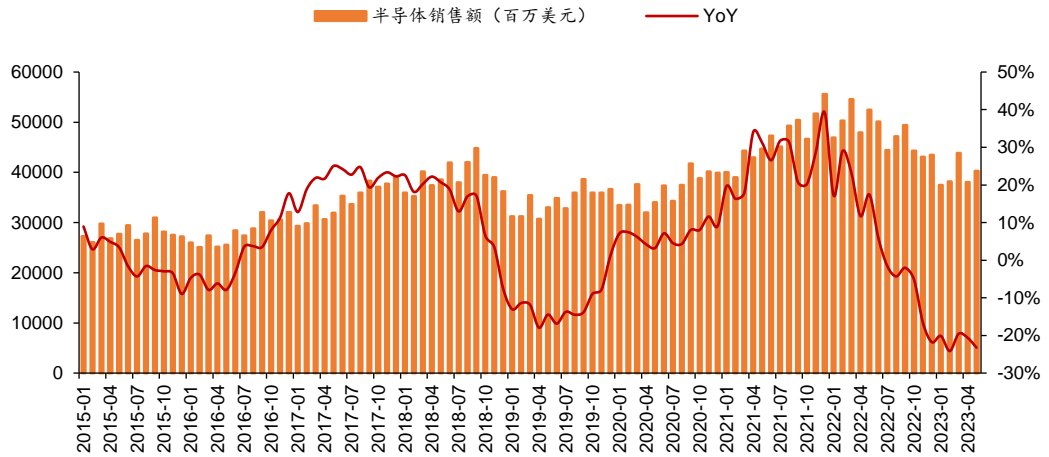
表 2: A 股公司要闻核心要点 (07.24-07.28)

公告日期	公司	公告类型	要闻
2023-07-26	复旦微电	限售股流通	公司本次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 12,000.00 万股, 并于 2021 年 8 月 4 日在上海证券交易所科创板上市, 发行完成后总股本为 814,502,000 股 (其中发行后 A 股总股本 530,172,000 股, H 股总股本 284,330,000 股)。发行后 A 股总股本中, 无限售条件流通股 79,739,128 股; 有限售条件流通股为 450,432,872 股, 含战略配售股 36,000,000 股。
2023-07-26	联创电子	对外投资	公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场, 利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑, 进一步开拓市场和更好的服务客户, 公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学 (美国) 有限公司 (以下简称“美国子公司”) 增资不超过 1,090 万美元, 以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位 PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A.P.I. DE C.V. 公司 (以下简称“Prodensa 公司”) 签订合作协议 (该协议基于墨西哥政府制定的 IMEX Shelter Program 模式), 投资总额不超过 1,090 万美元建设墨西哥工厂。
2023-07-27	希荻微	股份减持	宁波泓璟拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过 8,106,140 股, 占公司总股本的比例合计不超过 2%。截至 2023 年 7 月 27 日, 本次减持计划已实施完毕, 宁波泓璟已通过集中竞价方式累计减持公司股份 8,106,140 股, 占公司总股本的 2.00% (减持比例按照本次减持计划公告日公司总股本 405,307,014 股计算), 未以大宗交易方式减持公司股份。
2023-07-27	中微半导	限售股流通	本次上市流通的战略配售限售股份数量为 4,273,028 股, 占公司股本总数的 1.07%, 限售期为自中微半导体 (深圳) 股份有限公司 (以下简称“公司”、“中微半导”、“发行人”) 股票上市之日起 12 个月。本公司确认, 上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。除战略配售股份外, 本次上市流通的首发限售股数量为 68,085,000 股, 占公司股本总数的 17.01%, 限售期为自中微半导股票上市之日起 12 个月。
2023-07-28	顺络电子	半年报摘要	2023 年上半年营业收入约 23.32 亿元, 同比增加 9.17%; 归属于上市公司股东的净利润约 2.56 亿元, 同比减少 12.83%; 基本每股收益 0.32 元, 同比减少 13.51%。

资料来源: iFinD, 上海证券研究所

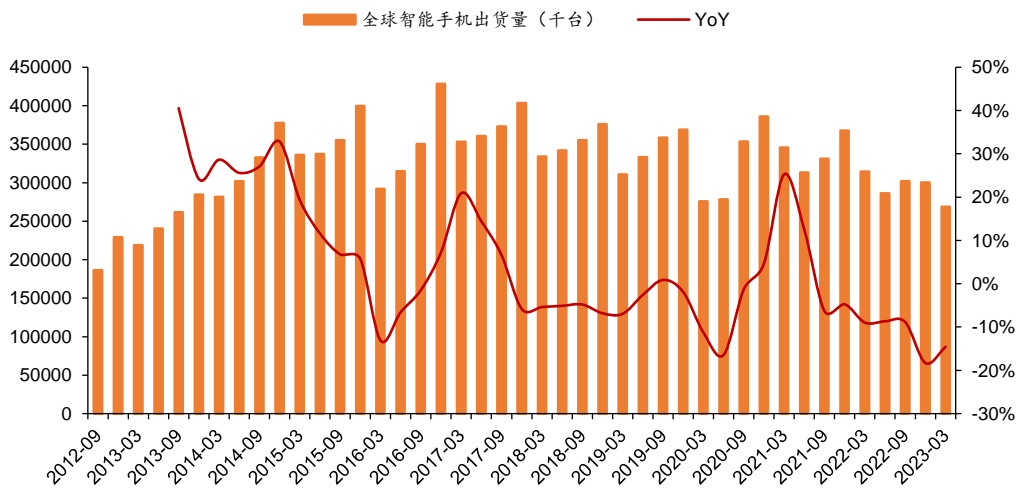
5 高频数据追踪

图 4：全球半导体销售额（单位：百万美元，截至 2023 年 5 月）



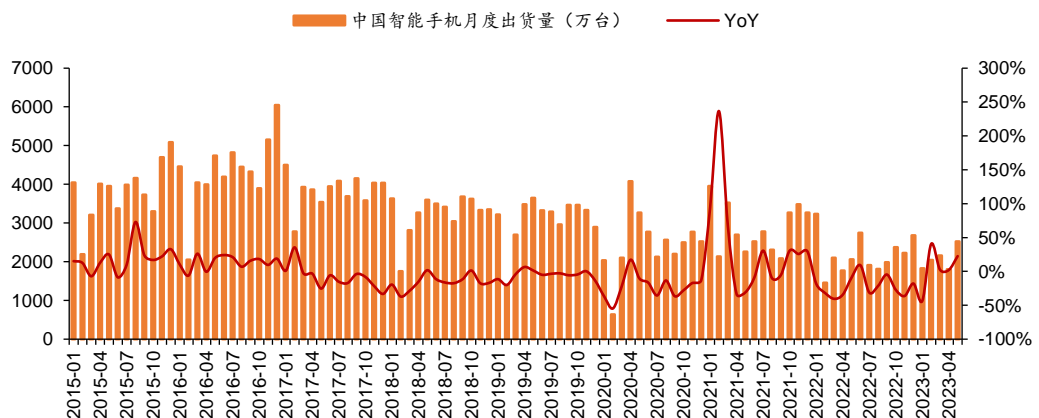
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 5：全球智能手机季度出货量（单位：千部，截至 2023 年 3 月）



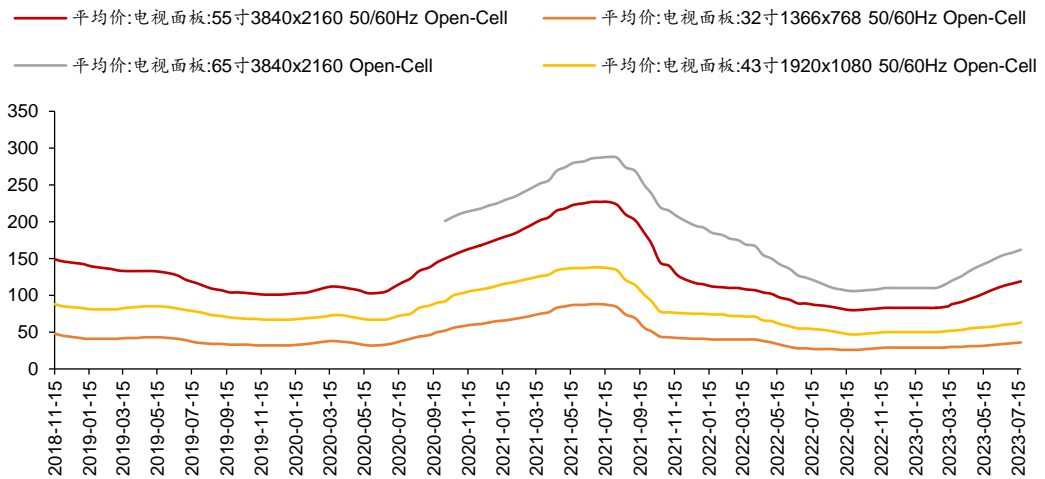
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 6：中国智能手机月度出货量（单位：万台，截至 2023 年 5 月）



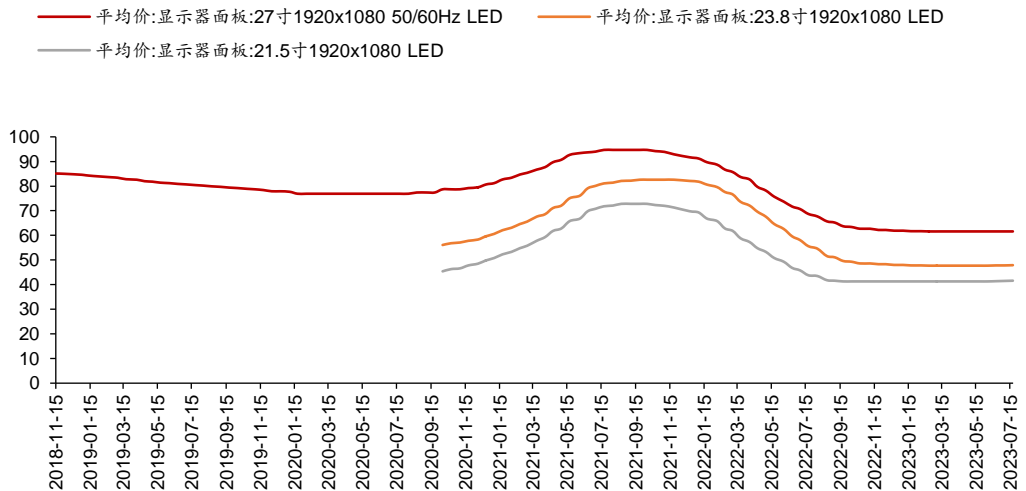
资料来源：iFinD，上海证券研究所

图 7: 电视面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)



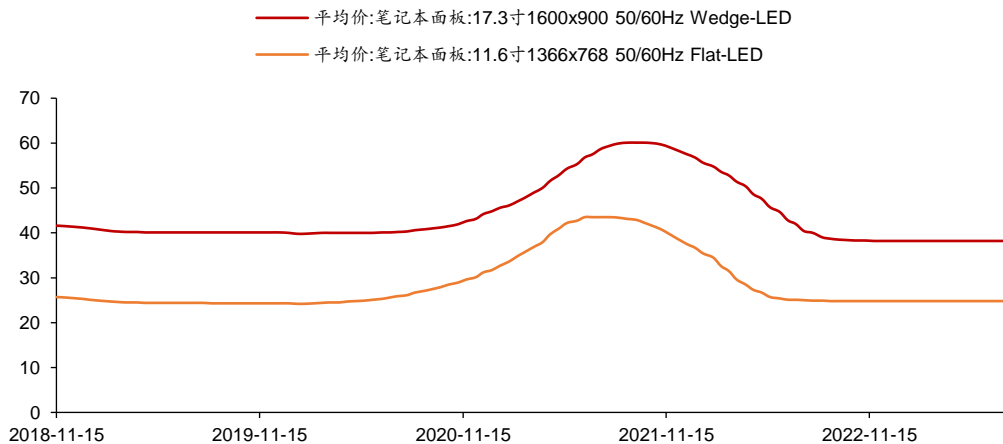
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 8: 显示器面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)



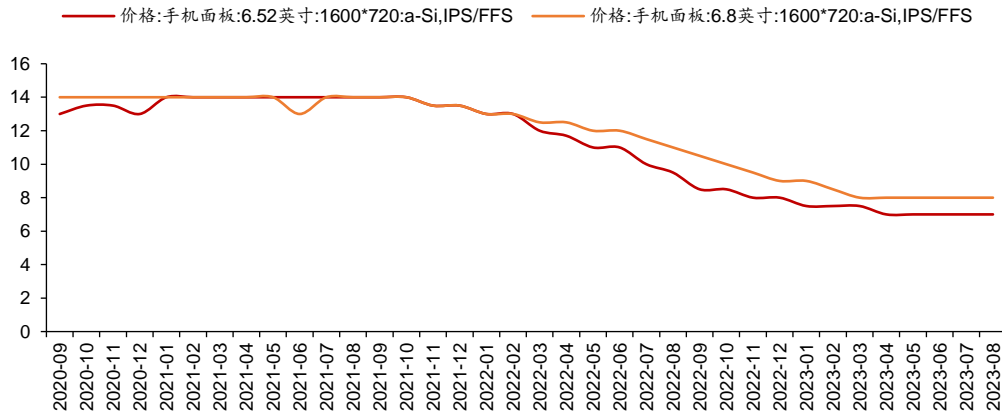
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 9: 笔记本面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 7 月 20 日)



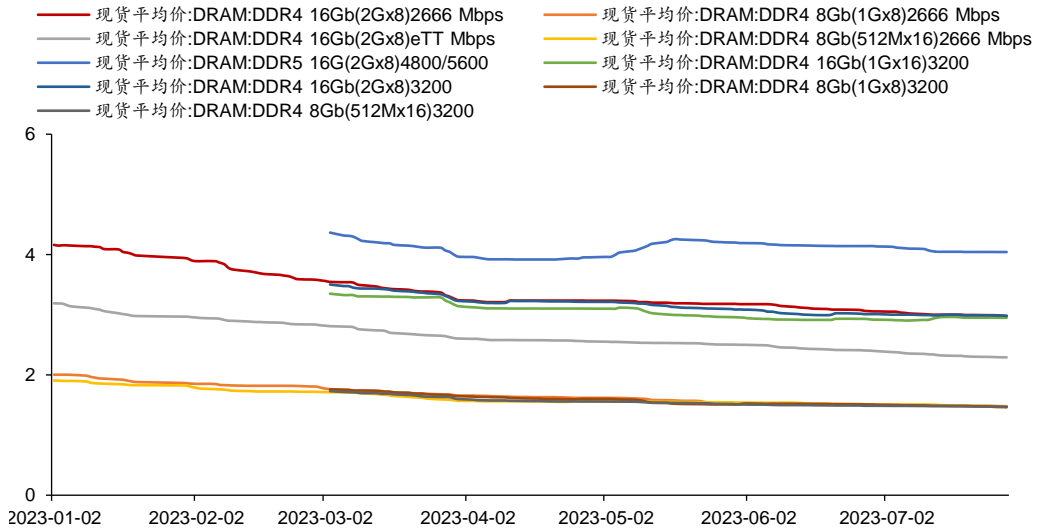
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 10: 手机面板价格 (单位: 美元/片, 截至 2023 年 8 月预测)



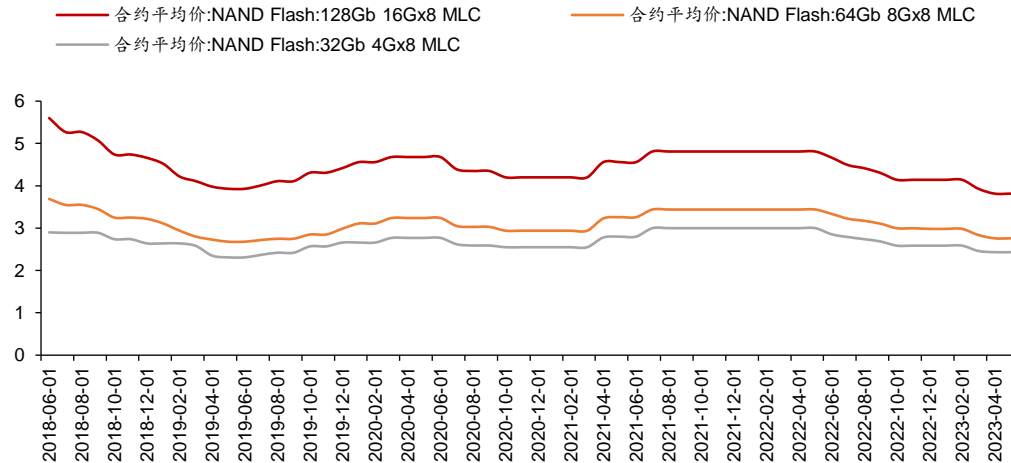
资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 11: DRAM 价格 (单位: 美元, 截至 2023 年 7 月 28 日)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

图 12: NAND Flash 价格 (单位: 美元, 截至 2023 年 5 月)



资料来源: iFinD, 上海证券研究所

6 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧

中美贸易摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，部分公司的经营或受到较大影响。

2) 终端需求不及预期

下游终端需求不及预期，产业链相关公司业绩或发生较大波动。

3) 国产替代不及预期

国产替代不及预期，国内企业的业绩或将面临承压。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。